

平成 12年 3月期 決算短信 (連結)

平成 12年 5月 30日

上 場 会 社 名 株式会社東京精密

上場取引所 東

コード番号 7729

本社所在都道府県

問合せ先 責任者役職名 取締役

東京都

氏 名 森内 信行

TEL (0422) 48 - 1011

決算取締役会開催日 平成 12年 5月 30日

1. 12年 3月期の連結業績 (平成 11年 4月 1日 ~ 平成12年 3月31日)

(1)連結経営成績

	売 上 高		営 業 利 益		経 常 利 益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
12年 3月期	46,176	43.6	8,104	399.9	8,138	254.9
11年 3月期	32,153	24.1	1,621	70.1	2,293	59.7

	当期純利益		1株当たり 当期純利益		潜在株式調整 後1株当たり当 期純利益	株主資本 当期純利益率	総資本 経常利益率	売上高 経常利益率
	百万円	%	円 銭	円 銭	円 銭	%	%	%
12年 3月期	4,422	517.8	118.43	117.95		14.3	15.9	17.7
11年 3月期	715	68.2	19.41	19.15		2.6	5.2	7.1

(注) 持分法投資損益 12年 3月期 - 百万円 11年 3月期 - 百万円
 有価証券の評価損益 2,645 百万円 デリバティブ取引の評価損益 - 百万円
 会計処理の方法の変更 無
 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2)連結財政状態

	総 資 産	株 主 資 本	株主資本比率	1株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
12年 3月期	61,007	33,433	54.8	890.55
11年 3月期	41,309	28,437	68.8	768.47

(3)連結キャッシュの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期 末 残 高
	百万円	百万円	百万円	百万円
12年 3月期	1,533	3,321	2,873	6,232
11年 3月期	-	-	-	-

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 7社 持分法適用非連結子会社数 0社 持分法適用関連会社数 0社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況

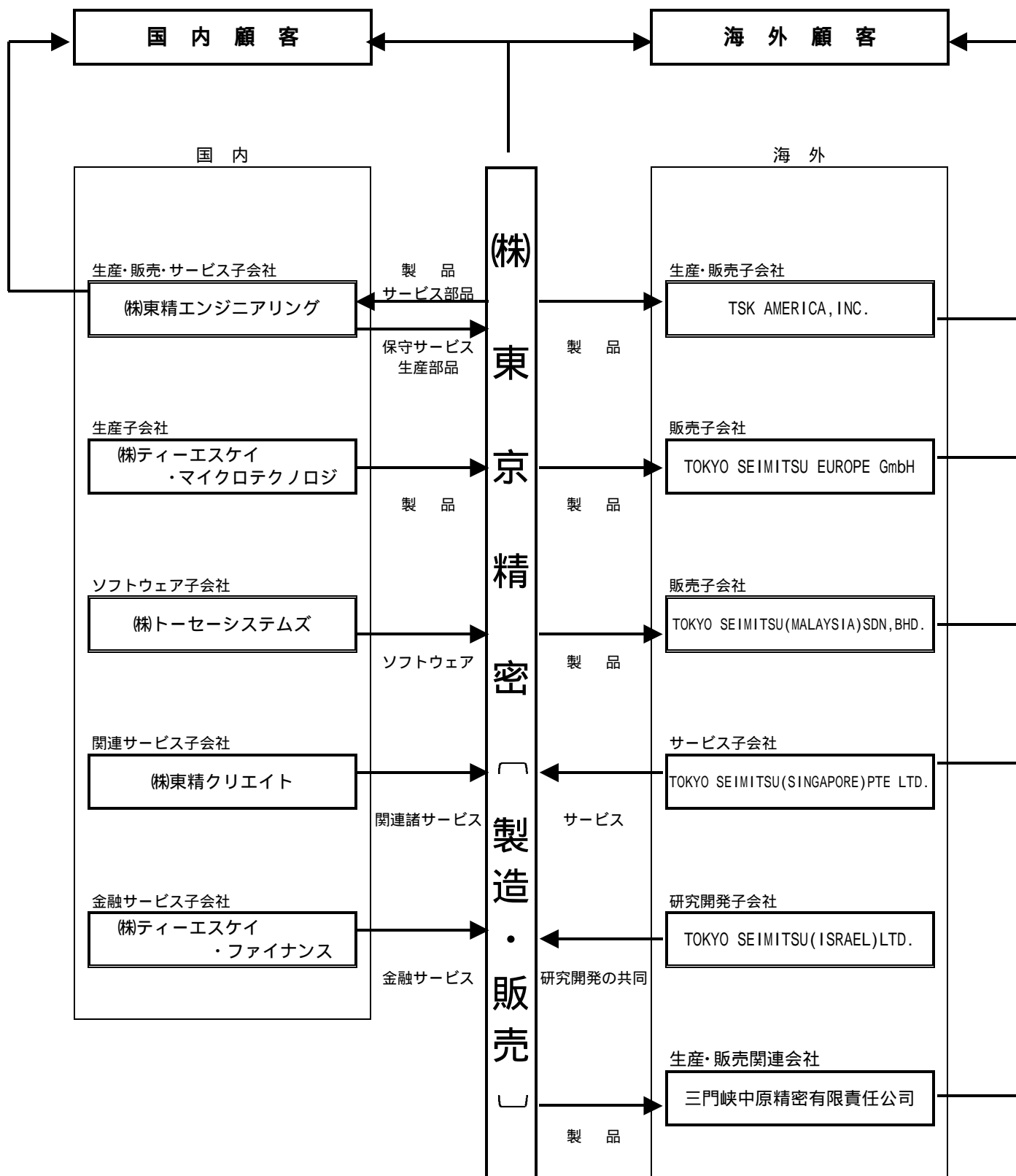
連結 (新規) 1社 (除外) 0社 持分法 (新規) 0社 (除外) 0社

2. 13年 3月期の連結業績予想 (平成 12年 4月 1日 ~ 平成 13年 3月 31日)

	売 上 高	経 常 利 益	当 期 純 利 益
	百万円	百万円	百万円
中間期	29,300	5,900	3,000
通 期	67,000	15,000	8,100

(参考) 1株当たり予想当期純利益 (通期) 215 円 75 銭

1 . 企業集団の状況



2. 経営の方針

(1) 基本方針

当社は精密計測機器および半導体製造用機器メーカーとして、常にお客さまの高生産性に寄与する最先端技術を駆使した製品開発とカスタマー・サポートに注力してまいりました。技術革新が高レベルかつ高スピードで進行する環境下、当社が発展し続けるために最も重要な事は、強い製品開発体制と適正な製品開発基準を持つことです。そこで、以下に掲げる「製品開発の原則」を当社の経営の大原則として、市場の設備投資動向の影響を最小限に抑えられ高成長、高収益のビジネス基盤を構築して、さらなる企業価値向上に努めております。

『製品開発の原則』

世界 No. 1 の製品を創る。

マーケットシェア No. 1 の商品は、

(a) 好況時は、利益の極大化がはかれる

(b) 不況時は、損失の極小化がはかれる

研究開発投資は自己資金で

技術参入障壁が高く、マーケットが大きく、ニーズも高い分野を狙う

市場規模が停滞縮小傾向にあるが、ユーザーとの関係で今後も R&D 投資が必要な製品は、競合先であってもアライアンスを組み、R&D コストをシェアする

設備投資循環の影響を受けない分野の開発も行う

また、「WIN-WIN の仕事で世界 No. 1 の商品を創ろう」を当社の行動指針として制定し、「製品開発の原則」遵守を徹底して推進しております。世界 No. 1 の製品開発には、様々な分野における最先端の技術とスピードが要求されています。そのためには、当社がこれまで培ってきたコア・テクノロジーを応用することに加え、国内外の垣根を越えて世界 No. 1 の製品創りという共通する目的を持つ会社および個人と“WIN-WIN”の協力関係を築くことが不可欠です。各国、各社の持つ異文化を包摂したグローバルかつハイブリッドな社風を醸成することにより、世界 No. 1 の製品開発体制を構築して、真のグローバル・カンパニーとなるべく努力しております。

(2) ユニークな開発体制

当社は、1988 年よりグループリーダー制を採用しています。各技術開発グループを製品群別に分け、各グループのヘッドであるグループリーダーは、製品開発のみならず、担当する製品群の業績全般についての責任を持っています。したがって、事業計画の作成や設備投資、人材の採用など、ヒト、モノ、カネの権限を大きく与えられています。また、グループリーダーは社長と直結しているため、この制度は、経営の動向を左右する開発計画などの意思決定が非常にスピーディーに行えるという大きな利点を備えています。さらに、半期毎にグループ別の実績および今後の市場動向などが社内検討され、ビジネス動向に応じ、対応策が迅速かつ柔軟に講じられる体制となっています。

(3) スリムかつ機能的な間接部門

当社は、スリムかつ機能的な間接部門の構築を推進しております。従来より間接部門は、極めて少ない人員で運営しておりますが、機能性をさらに強化するため、本年 4 月に従来の縦割り組織から機能重視型組織へ、すなわち、企画立案機能全般を担当する「企画部」と日常業務などの実務を担当する「業務部」へ改組しました。

当社の中期計画遂行に伴う今後の業績拡大を考えますと、間接部門を現状のサイズで維持することは容易ではありません。また、情報・通信技術が目覚ましい進展を遂げる中、経営環境も猛烈な勢いで変貌しており、経営情報的確な把握と変化に対応した経営戦略の企画立案機能の強化も益々重要となってきています。これらの課題を解決する体制として、上記の新体制を導入いたしました。

業務部は、実務のプロとしての眼で業務を見直し、種々の効率化およびシステム化、標準化を図り、日常業務の簡素化を推進します。企画部は、戦略的な案件の具体的立案と推進を行います。

(4) 利益配分に関する基本方針

当社は、常に成長分野において、最先端技術を駆使した世界 No.1 製品を提供し続けることにより、企業価値を高め、株主の皆様へ利益還元を図りたいと考えております。配当につきましては、将来の事業展開のための企業体質強化に配慮の上、業績に対応した配当を実施してまいりたいと考えております。

内部留保金につきましては、当社が成長を続けていくために不可欠な研究開発投資、生産設備投資などに有効に活用してまいりたいと存じます。

(5) コーポレートガバナンスの充実および経営力強化に関する施策

企業の経営環境が目覚ましい変化を遂げる中、その変化のスピードに対応できる経営体制と、経営の国際標準化および株主重視経営推進のためのコーポレート・ガバナンスの強化は、当社が永続的に発展するために不可欠であります。そこで、経営機構改革に着手して、本年4月より下記の体制を導入いたしました。

経営機構の「動態」組織化

激変していく企業の経営環境に迅速かつ柔軟に対応して、具体的な経営戦略を策定し、業務執行を変化させていくことができる機動性のある組織の構築を目指して、「動態」組織と名付けました。情報収集と意思決定の更なるスピード化を目指して、社長、常務、グループリーダーを組織の核とし、情報が高速に伝達、共有される仕組みを構築いたしました。主な内容は、以下のとおりです。

(A) 常務取締役に代表権を付与する。

- ・それぞれの明確な役割権限のもと、新規プロジェクトなどを一段と速いスピードで推進していく。
- ・各代表取締役間での情報を高速に伝達、共有して、相互間の意見表明の自由度を高め、新規ビジネスなどの立案から決定までのスピードを上げる。
- ・対外交渉力を強化する。

(B) グループリーダーの役割を徹底、強化する。

- ・従来より、製品開発責任者であるグループリーダーは、社長と直結し、販売・利益に対しての責任を持っていたが、それに加え、グループリーダーと代表取締役常務主導の組織である営業およびサービス部門との直結ラインの強化を図る。また、製造部門については、製造部門の要の工場長とクロス管理を徹底する。

コーポレート・ガバナンス強化策

当社は、株主重視の経営を推進しておりますが、株主利益の反映および経営の透明性などの強化のため、以下のような新しい機構を本年4月に導入いたしました。

(A) 「アドバイザー・ボード」(諮問委員会)を新設 監査役に諮問委員を嘱託

- ・監査役をメンバーとする、取締役会議長の諮問機関として「アドバイザー・ボード」を新設し、経営上の意見を自由に取締役会議長に助言する。
- ・従来の監査役の「違法性」の判断に加え、「妥当性」の判断にまで踏み込んでもらう。

(B) 「常務理事」を新設 取締役会および役員会(経営会議)の活性化

- ・取締役会が迅速で効率的な意思決定が出来るよう、取締役の人数は少数とする。但し、役員会の議論の活発化および「開かれた役員会」を目指して、「常務理事」(役員待遇、但し資格は従業員)を新設し、役員会に参加させる。これにより、現場の意見が経営戦略により強く迅速に反映できる。
 - ・取締役を適正人数に維持しながら、役員に準ずる者を適正に処遇できる。
- また、従業員および取締役の定年は60歳だが、本措置により定年を超えて、優秀な技術者の確保にも貢献できる。

(C) 「役員報酬委員会」を新設 経営の透明性の向上

- ・経営の透明性の向上の一環として、役員報酬委員会を新設して、取締役の待遇の原案を作成する。アドバイザー・ボードがこの案を検討して、取締役会議長に意見を述べる。

(6) 目標とする経営指標

当社は、株主が当社株式を所有する目的に沿った経営を行っております。従って、一株当たり利益の長期的な上昇とその結果としての企業価値の長期的な上昇を経営上重要な指標と考えます。

(7) 役員および従業員に対するインセンティブに関する方針

当社は、役員および従業員にインセンティブ社債をこれまで6回発行しております。株主利益重視の視点を増大するため、役員に対しては常に経営改革を進めるための手段、動機づけとなることを期待し、従業員に対しては優秀な人材の確保が主な狙いです。

(8) 自己株買入消却について

当社は、一株当たり利益の拡大を重視した経営を実施しております。そのために、機動的に今後も自己株式を取得し消却を進めてまいります。

(9) 会社が対処すべき課題

当社は、更なる躍進を目指し、半導体製造用機器部門において成長分野である市場に新たに参入すべく、近年それら新製品の開発に注力してまいりました。それらの新製品「ウエーハ外観検査装置」「CMP(ウエーハ表面研磨装置)」「ポリッシュ・グライнда(ウエーハ裏面研磨装置)」は、現在複数のユーザーサイトにて評価中です。これら新製品を予定通り業績に貢献させ、売上の飛躍的な拡大と高収益基盤を確立することを目指し、最大の努力をしてまいります。

次に、当期より拡大基調に転じました半導体市場の顧客ニーズおよび変化に対応できるような生産ラインの構築に取り組んでいきます。生産能力の増強とともに、リードタイムの短縮が急務であり、現在、社内外のリソースを使って新しいシステム作りを進めております。

また、ITビジネスの飛躍的な成長に伴い、市場の変化には目覚ましいものがあり、経営のスピード化が必須であります。そのニーズに対応して本年4月に新しい経営機構を導入し間接部門をスリムかつ機能的に改組いたしました。社内インフラの強化を含め、今後とも継続的に努力してまいります。

株主の皆様におかれましては、今後ともよろしくご支援を賜りますようお願い申し上げます。

3. 経営成績

(1) 当期の概況

当期の半導体業界は、前年度の不況から回復に転じ、インターネットや通信市場の躍進により、世界的に半導体市場は活況を呈しました。従来の半導体市場の牽引役であったパソコンおよびパソコン周辺機器に加え、新たな市場牽引役として台頭してきた情報通信機器およびデジタル家電そしてゲーム機器と全製品分野で半導体の需要が拡大しました。その結果、半導体メーカーの設備投資も活発化して、当社半導体製造用機器部門の主要製品であるウェーハプロービングマシンおよびダイシングマシンは、既往最高の売上高を記録し、当社の半導体製造用機器部門全体の売上高も、既往最高となりました。

生産面では、リードタイムの短縮と生産の効率化およびコストダウンを全製品の課題として推進いたしました。また、世界No.1のマーケットシェアを誇るウェーハプロービングマシンの月間生産台数は既往最高を記録しました。

近年不採算が続いておりましたウエーハマニファクチャリング製品につきましては、平成11年4月から開発および製造を子会社の(株)東精エンジニアリングに移管して、ビジネスの合理化を実施し黒字化いたしました。

計測製品部門につきましては、前年からの自動車産業、工作機械業界の設備投資抑制のトレンドが一段と深まり、大変厳しいビジネス環境でありました。このような状況のもと、営業面では環境対策関連等の限られた設備投資を確実に受注に取り込むべく努力するとともに、生産面では、人員の半導体部門への配置転換などを含むコストダウンを推進して、売上、利益ともに最小限の落ち込みに留めることができました。

研究開発面では、引き続き、市場ニーズに適合する次世代装置のタイムリーな開発に注力いたしました。その成果として、新規参入製品「ウエーハ外観検査装置」「CMP(ウエーハ表面研磨装置)」「ポリッシュ・グライнда(ウエーハ裏面研磨装置)」は、当期予定どおりユーザーへ評価用として出荷いたしました。また、対向式の2つのスピンドルを搭載したダイシングマシンの新製品「A-WD-200T」の出荷を開始して、ダイシングマシンの売上に大きく貢献しました。

この結果、当期の当グループの売上高は461億76百万円(前期比43.6%増)、経常利益は81億38百万円(前期比254.9%増)、当期純利益は44億22百万円(前期比517.8%増)となりました。

部門別の概況は、次のとおりです。

〔半導体製造用機器部門〕

半導体市場の活況を反映して、売上高は、前期比86.3%増の338億11百万円と既往最高を記録いたしました。また、前期不採算であった製品分野は、新製品の投入、ビジネスの合理化などで黒字化いたしました。

〔計測機器部門〕

設備投資抑制の状況下、拡販に努めましたが、売上高は、前期比11.7%減の123億64百万円となりました。

(2) 次期の見通し

次期の半導体市場は引き続き活況を呈し、半導体メーカーの設備投資は全世界的に一段と活発化することが予想されます。このような見通しのもと、当社といたしましては、半導体製造用機器部門の主力製品であるウエーハプロベリングマシンおよびダイシングマシンの生産能力の増強および納期短縮を強力に推進して、市場ニーズに応えてまいりたいと存じます。また、前期に市場投入して、複数のユーザーサイトで評価中の新製品は、今期本格的に国内外の半導体メーカーへ、ビジネス展開していく予定でございます。当社の新たなコアビジネスとするべく、生産、ユーザー・サポート、販売体制を一段と強化していく予定でございます。

一方、計測部門につきましては、情報通信機器およびパソコン市場の活況で、ハードディスクドライブなどの生産増強に伴う設備投資が活発化して、当社の自動計測機器は、前期より好転すると予想しております。しかし、計測機器につきましては、引き続き設備投資抑制のトレンドが継続傾向にあると予想しております。一層の生産の効率化およびコスト削減を徹底していく所存でございます。

以上のような予測のもと、次期の売上高は、670 億円（前期比 45.1%増）、経常利益 150 億円（前期比 85.1%増）、当期純利益 81 億円（前期比 83.2%増）を見込んでおります。

4 . 配当政策

当社は、常に成長分野において、最先端技術を駆使した世界 No.1 製品を提供し続けることにより企業価値を高め、株主の皆様へ利益還元を図りたいと考えております。基本方針としては、将来の事業展開のための企業体質強化に配慮の上、業績に対応した配当を実施してまいりたいと考えております。

当期配当金につきましては、上記のような高業績を確保することができ、株主の皆様のご支援に報いるため、前期の創業 50 周年記念配当 6 円を今期は普通配当とするよう、すでに中間配当を 9 円 50 銭とさせていただきます。当期末配当金も 1 株につき 9 円 50 銭(中間配当と合わせて年 19 円)とさせていただきます予定です。

内部留保金につきましては、当社が成長を続けていくために不可欠な研究開発投資、生産設備投資などに有効に活用してまいりたいと存じます。

5 . 西暦 2000 年問題

当社では、「Y2K プロジェクト」を発足させ、顧客対応及び社内情報システムの整備をいたしました。その結果、当社の業務状況に影響をおよぼす事項は発生しておりません。

6 . 設備投資計画

前期より活況を呈しております半導体市場の勢いは、引き続き継続すると予想されます。また、当社の新製品は、来年度より急速にビジネスが拡張すると考えております。そのため、ウエーハプロベリングマシンでは、24 時間生産体制を本年 4 月から導入したほか、新製品を含めた生産能力の大幅拡充を図るべく新たに八王子工場内に 11 階建の工場を建築中であり 2001 年 3 月完成予定です。その建物の完成により、「CMP(ウエーハ表面研磨装置)」「ポリッシュ・グラインダ(ウエーハ裏面研磨装置)」の生産能力の増強を図ります。また、ウエーハプロベリングマシン、ダイシングマシンの生産能力もそれぞれ月産 50%増強されます。ウエーハ外観検査装置につきましては、市場の成長性を鑑み、現在建築中の建物が完成後、さらにウエーハ外観検査装置専用工場を増設する予定です。完成は、2002 年 1 月頃を目処と考えております。

7 . 比較連結貸借対照表

(単位 百万円：百万円未満を切り捨てて表示)

科 目	当 期 (平成 12 年 3月 31 日現在)	前 期 (平成 11 年 3月 31 日現在)	科 目	当 期 (平成 12 年 3月 31 日現在)	前 期 (平成 11 年 3月 31 日現在)
資 産 の 部			負 債 の 部		
流 動 資 産	46,617	32,487	流 動 負 債	20,664	8,794
現金及び預金	6,402	4,934	支払手形及び売掛金	13,199	5,700
受取手形及び売掛金	16,357	10,587	短期借入金	389	550
有価証券	3,732	2,931	一年以内に返済する 長期借入金	380	43
たな卸資産	18,472	13,721	未払法人税等	3,584	171
未収消費税等	317	-	未払消費税等	-	43
繰延税金資産(流動)	573	42	賞与引当金	738	765
その他流動資産	859	349	その他流動負債	2,372	1,520
貸倒引当金	97	79			
固 定 資 産	14,240	8,687	固 定 負 債	6,656	3,875
(有形固定資産)	(8,584)	(7,319)	社 債	250	250
建物及び構築物	4,525	2,913	転換社債	58	104
機械装置及び運搬具	2,254	1,187	長期借入金	3,250	436
工具器具備品	741	571	退職給与引当金	2,786	2,780
土地	810	847	役員退職慰労引当金	311	277
建設仮勘定	251	1,798	その他の固定負債	-	27
(無形固定資産)	(3,927)	(95)	負 債 合 計	27,321	12,670
ソフトウェア	3,780	-			
その他無形固定資産	146	95	少数株主持分	252	201
(投資その他の資産)	(1,729)	(1,272)			
投資有価証券	350	396	資 本 の 部		
長期貸付金	226	262	資 本 金	7,011	6,588
繰延税金資産(固定)	582	-	資 本 準 備 金	11,588	11,093
その他の投資			連 結 剰 余 金	14,836	10,755
その他の資産	589	629	自 己 株 式	3	0
貸倒引当金	19	16			
繰 延 資 産	0	0	資 本 合 計	33,433	28,437
社債発行差金	0	0			
為替換算調整勘定	149	134	負債、少数株主持分 及び資本合計	61,007	41,309
資 産 合 計	61,007	41,309			

8 . 比較連結損益計算書

(単位 百万円：百万円未満を切り捨てて表示)

科 目		期 別	当 期	前 期	
			自 平成 11 年 4 月 1 日 至 平成 12 年 3 月 31 日	自 平成 10 年 4 月 1 日 至 平成 11 年 3 月 31 日	
経 常 損 益 の 部	営業 損 益 の 部	売 上 高	46,176	32,153	
		売 上 原 価	29,707	22,884	
		売 上 総 利 益	16,468	9,268	
	販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 の 部	販 売 費	(8,363)	(7,647)	
		一 般 管 理 費	6,397	5,708	
			1,966	1,939	
	営 業 利 益		8,104	1,621	
	営 業 外 損 益 の 部	営 業 外 損 益 の 部	営 業 外 収 益	(451)	(761)
			受 取 利 息	33	30
			受 取 配 当 金	26	33
有 価 証 券 売 却 益			313	60	
為 替 差 益			-	82	
生 命 保 険 金 給 付 収 入			-	421	
そ の 他			77	133	
営 業 外 費 用			(417)	(89)	
支 払 利 息			88	46	
為 替 差 損			191	-	
固 定 資 産 除 却 損	-	12			
そ の 他	136	29			
経 常 利 益		8,138	2,293		
特 別 損 益 の 部	特 別 損 益 の 部	特 別 利 益	(185)	(3)	
		土 地 売 却 益	185	3	
		特 別 損 失	(78)	(532)	
		有 価 証 券 評 価 額	46	532	
	英 国 子 会 社 清 算 損	32	-		
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益		8,245	1,764		
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税		4,154	1,057		
法 人 税 等 調 整 額		374	23		
少 数 株 主 利 益		42	13		
当 期 純 利 益		4,422	715		

9. 比較連結剰余金計算書

(単位 百万円：百万円未満を切り捨てて表示)

別 科 目	当 期		前 期	
	自平成11年4月1日 至平成12年3月31日		自平成10年4月1日 至平成11年3月31日	
連結剰余金期首残高	10,755			
1. その他の剰余金期首残高	-		10,371	
2. 利益準備金期首残高	-		431	
3. 過年度税効果調整額	762	11,517	-	10,802
連結剰余金減少高				
1. 配当金	816		495	
2. 取締役賞与金	54		58	
3. 自己株式消却額	231	1,102	208	762
当期純利益		4,422		715
連結剰余金期末残高		14,836		10,755

(注記事項)

(単位 百万円：百万円未満を切り捨てて表示)

	[当期]	[前期]
1. 受取手形割引高	4,464	2,596
2. 自己株式	253株	148株
3. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額		
[工具器具及び備品]	[当期]	[前期]
取得価額相当額	216	255
減価償却累計相当額	114	137
期末残高相当額	101	117
未経過リース料期末残高相当額		
— 年以内	39	44
— 年を超	65	76
合 計	105	121
支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額		
支払リース料	51	52
減価償却費相当額	46	47
支払利息相当額	4	5

減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法に付いては、利息法によっている。

10. 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円：百万円未満を切り捨てて表示)

科 目	期 別	当連結会計年度
		自平成11年4月1日 至平成12年3月31日
		金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益		8,245
減価償却費		1,243
退職給与引当金の増加額		39
貸倒引当金の増加額		20
受取利息及び受取配当金		59
支払利息		88
為替差益		226
長期前払費用償却費及び社債発行差金償却費		41
有価証券売却益		313
有価証券評価損		46
土地売却益		185
英国子会社清算損		32
有形固定資産売却除却損		13
売上債権の増加額		5,769
たな卸資産の増加額		7,777
その他の資産の増加額		906
仕入債務の増加額		7,498
その他の債務の増減額		328
取締役員賞与の支払額		55
小計		2,304
利息及び配当金の受取額		59
利息の支払額		88
法人税等支払額		741
営業活動によるキャッシュ・フロー 計		1,533
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有価証券の取得による支出		933
有価証券の売却による収入		400
有形固定資産の取得による支出		2,239
有形固定資産の売却による収入		374
無形固定資産の取得による支出		801
投資有価証券の取得による支出		4
投資有価証券の売却による収入		3
英国子会社投資の回収による収入		14
貸付金の実行による支出		47
貸付金の回収による収入		85
その他の投資に関する支出		173
投資活動によるキャッシュ・フロー 計		3,321
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金 減少額		161
長期借入金 による収入		3,200
長期借入金 返済による支出		48
社債発行による収入		132
新株引受権の権利行使による収入		799
自己株式消却による支出		231
配当金の支払額		820
その他財務活動による収入(純額)		2
財務活動によるキャッシュ・フロー 計		2,873
現金及び現金同等物に係る換算差額		212
現金及び現金同等物の増加額		1,297
現金及び現金同等物の期首残高		4,934
現金及び現金同等物の期末残高		6,232

1 1 . 連結財務諸表作成の基本となる事項

1 . 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社 (7 社)

(株)東精エンジニアリング、(株)トーセシステムズ、(株)ティーエスケイ・マイクロテクノロジー
(株)東精クリエイト、(株)ティーエスケイ・ファイナンス、TSK AMERICA, INC.、TOKYO SEIMITSU
EUROPE GmbH

(2) 非連結子会社 (3 社)

TOKYO SEIMITSU(MALAYSIA)SDN,BHD.、TOKYO SEIMITSU(ISRAEL)LTD.、TOKYO SEIMITSU
(SINGAPORE)PTE LTD.

連結の範囲から除いた理由は、上記3社いずれも小規模会社であり、合計の総資産・売上高・
当期純損益及び剰余金の金額がいずれも僅少であり、連結財務諸表に重要な影響を及ぼさない
ためであります。

2 . 持分法の適用に関する事項

非連結子会社及び関連会社三門峡中原精密有限責任公司については、それぞれ連結純損益及び連
結剰余金に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、これらの会社に対する
投資については、持分法を適用せず原価法により評価しております。

3 . 連結子会社の事業年度に関する事項

連結子会社の決算日は連結決算日と一致しております。

4 . 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

(イ) 有価証券

主として移動平均法による原価法を採用しております。

(ロ) たな卸資産

商品・製品・材料及び貯蔵品については、主として先入先出法による原価法、仕掛品につ
いては個別法による原価法であります。

(2) 固定資産の減価償却の方法

(イ) 有形固定資産

主として定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以降取得した建物(建物
付属設備は除く)については、法人税法に定める定額法によっております。

(ロ) 無形固定資産

市場販売目的のソフトウェアは、見込販売数量に基づく方法又は残存有効期間(3年以内)
に基づく定額法によっており、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期
間(5年)に基づく定額法によっております。

その他の無形固定資産は、法人税法に規定する定額法であります。

当期より市場販売目的のソフトウェアについては、「流動資産」の「たな卸資産」から「無
形固定資産」の「ソフトウェア」に、自社利用のソフトウェアについては、「投資その他の
資産」の「その他」から「無形固定資産」の「ソフトウェア」に表示を変更しております。

(3) 繰延資産の処理方法

(イ) 社債発行費

支出時に全額経費として処理しております。

(ロ) 社債発行差金

普通社債に係る社債発行差金については、社債償還期間(7年)にわたり均等償却して
おります。

(4) 重要な引当金の計算基準

(イ) 貸倒引当金

債権の貸倒の損失に備えるため、法人税法の規定により、法定繰入率による繰入限度額のほか債権の実情に応じた個別の引当額を計上しております。

(ロ) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額基準により計上しております。

(ハ) 退職給与引当金

従業員に対する退職金の支払いに備えるため、適格退職年金制度支給分を除き、自己都合による退職給与期末要支給額を基準とした現価方式で主として計上しております。

(ニ) 役員退職慰労引当金

役員の退任時に支出が予想される役員退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づく期末支払見込額を計上しております。

(5) 重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(6) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

5. 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

該当事項はありません。

6. 連結調整勘定の償却に関する事項

該当事項はありません。

7. 利益処分項目等の取扱に関する事項

連結剰余金計算書は連結会社の利益処分について、連結会計年度中に確定した利益処分に基づいて作成しております。

8. 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

12. セグメント情報

(イ) 事業の種類別セグメント情報

前 期 (平成 10 年 4 月 1 日 ~ 平成 11 年 3 月 31 日)

(単位 百万円：百万円未満を切り捨てて表示)

	半導体製造用 機器関連事業	計測機器 関連事業	計	消 去 又 は 全 社	連 結
.売上高及び営業損益					
(1) 外部顧客に対する売上高	18,150	14,002	32,153	-	32,153
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	-	-	-	(-)	-
計	18,150	14,002	32,153	(-)	32,153
営業費用	18,418	12,113	30,531	(-)	30,531
営業利益	267	1,889	1,621	-	1,621
.資産、減価償却費及び資本的支出					
資 産	22,798	13,611	36,410	4,899	41,309
減 価 償 却 費	532	292	825	-	825
資 本 的 支 出	2,023	594	2,617	-	2,617

当 期 (平成 11 年 4 月 1 日 ~ 平成 12 年 3 月 31 日)

(単位 百万円：百万円未満を切り捨てて表示)

	半導体製造用 機器関連事業	計測機器 関連事業	計	消 去 又 は 全 社	連 結
.売上高及び営業損益					
(2) 外部顧客に対する売上高	33,811	12,364	46,176	-	46,176
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	-	-	-	(-)	-
計	33,811	12,364	46,176	(-)	46,176
営業費用	27,284	10,786	38,071	(-)	38,071
営業利益	6,527	1,577	8,104	-	8,104
.資産、減価償却費及び資本的支出					
資 産	45,071	13,023	58,095	2,912	61,007
減 価 償 却 費	938	306	1,244	-	1,244
資 本 的 支 出	3,176	304	3,481	-	3,481

(注) 1. 当社の事業区分は、製品の種類・性質及び販売市場等の類似性を考慮して行っております。

2. 各事業区分の主要製品

(1) 半導体製造用機器関連事業

ウェーハプロービングマシン、ウェーハダイシングマシン

ウェーハマニファクチャリングマシン

(2) 計測機器関連事業

三次元座標測定機、表面粗さ・輪郭形状測定機、真円度・円柱形状測定機

電気マイクロメータ、マシンコントロールゲージ、各種自動測定・選別・組立機

3. 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金（預金及び有価証券）、長期投資資金（出資金及び投資有価証券）等であり、その金額は次のとおりであります。

[前 期] 4,899 百万円

[当 期] 2,912 百万円

(ロ) 所在地別セグメント情報

前 期 (平成 10 年 4 月 1 日 ~ 平成 11 年 3 月 31 日)

(単位 百万円: 百万円未満を切り捨てて表示)

	日 本	米 国	ドイ ツ	計	消 却 又は全社	連 結
. 売上高及び営業損益						
(3) 外部顧客に対する売上高	27,202	2,594	2,355	32,153	-	32,153
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	3,215	47	42	3,304	(3,304)	-
計	30,417	2,642	2,397	35,457	(3,304)	32,153
営 業 費 用	27,796	3,412	2,265	33,474	(2,942)	30,531
営 業 利 益	2,621	769	131	1,983	(362)	1,621
. 資 産	36,389	2,391	842	39,623	1,685	41,309

当 期 (平成 11 年 4 月 1 日 ~ 平成 12 年 3 月 31 日)

(単位 百万円: 百万円未満を切り捨てて表示)

	日 本	米 国	ドイ ツ	計	消 却 又は全社	連 結
. 売上高及び営業損益						
(4) 外部顧客に対する売上高	37,911	4,982	3,281	46,176	-	46,176
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	5,138	-	21	5,159	(5,159)	-
計	43,050	4,982	3,302	51,335	(5,159)	46,176
営 業 費 用	35,140	5,025	2,932	43,098	(5,026)	38,071
営 業 利 益	7,910	42	370	8,237	(133)	8,104
. 資 産	56,825	3,147	1,558	61,531	(523)	61,007

(注) 1. 国別の区分の方法

国別の区分の方法は、事業活動の地域的独立性に基づいて決定しております。

2. 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）等であり、その金額は次のとおりです。

[前 期] 4,899 百万円

[当 期] 2,912 百万円

(ハ) 海外売上高

前 期 (平成 10 年 4 月 1 日 ~ 平成 11 年 3 月 31 日)

(単位 百万円: 百万円未満を切り捨てて表示)

	東アジア	北 米	欧 州	そ の 他	計
. 海 外 売 上 高	5,001	2,573	2,558	1,199	11,333
. 連 結 売 上 高					32,153
. 連 結 売 上 高 に 占 め る 海 外 売 上 高	15.6%	8.0%	7.9%	3.7%	35.2%

当 期 (平成 11 年 4 月 1 日 ~ 平成 12 年 3 月 31 日)

(単位 百万円: 百万円未満を切り捨てて表示)

	東アジア	北 米	欧 州	そ の 他	計
. 海 外 売 上 高	9,018	4,334	3,545	2,279	19,178
. 連 結 売 上 高					46,176
. 連 結 売 上 高 に 占 め る 海 外 売 上 高	19.5%	9.4%	7.7%	4.9%	41.5%

(注) 1. 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高です。

2. 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

(1) 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によつています。

(2) 各区分に属する主な国又は地域

東アジア.....韓国、台湾、中国

北 米.....米国、カナダ

欧 州.....ドイツ、英国、イタリア

そ の 他.....シンガポール、マレーシア、フィリピン

1 4 . 生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

当連結会計年度の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。
(単位 百万円：百万円未満を切り捨てて表示)

事業の種類別セグメントの名称	当 連 結 会 計 年 度	
	自 平成 11 年 4 月 1 日 至 平成 12 年 3 月 31 日	前年同期比 (%)
半 導 体 製 造 用 機 器	38,048	- %
計 測 機 器	12,737	- %
合 計	50,786	- %

(注) 金額表示は販売価格(消費税抜き)によっております。

(2) 受注状況

当連結会計年度の受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。
(単位 百万円：百万円未満を切り捨てて表示)

区 分	受 注 高		受 注 残 高	
	前年同期比 (%)	前年同期比 (%)	前年同期比 (%)	前年同期比 (%)
半 導 体 製 造 用 機 器	39,858	- %	10,863	- %
計 測 機 器	12,362	- %	2,496	- %
合 計	52,220	- %	13,360	- %

(注) 金額表示は販売価格(消費税抜き)によっております。

なお、当連結会計年度は「生産、受注及び販売の状況」を連結ベースで作成する初年度である為、生産実績及び受注状況については、前年同期比との比較は行っておりません。

(3) 販売実績

当連結会計年度の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。
(単位 百万円：百万円未満を切り捨てて表示)

区 分	当 連 結 会 計 年 度		前 連 結 会 計 年 度	
	平成 11 年 4 月 1 日 平成 12 年 3 月 31 日	前年同期比 (%)	平成 10 年 4 月 1 日 平成 11 年 4 月 31 日	前年同期比 (%)
半 導 体 製 造 用 機 器	33,811	86.3%	18,150	32.8%
計 測 機 器	12,364	11.7%	14,002	8.7%
合 計	46,176	43.6%	32,153	24.1%

(注) 金額表示は消費税抜きであります。

15. 有価証券及びデリバティブ取引の状況

* 前事業年度（平成 11 年 3 月 31 日現在）については、個別財務諸表の概要の添付資料として記載しております。

(1) 有価証券の時価等

(単位：百万円)

種 類	当 連 結 会 計 年 度 (平成 12 年 3 月 31 日現在)		
	連結貸借対照表計上額	時 価	評 価 損 益
流動資産に属するもの			
株 式	3,692	6,337	2,645
債 権	40	39	0
そ の 他	-	-	-
小 計	3,732	6,377	2,645
固定資産に属するもの			
株 式	-	-	-
債 権	-	-	-
そ の 他	-	-	-
小 計	-	-	-
合 計	3,732	6,377	2,645

(注) 1. 時価（時価相当額を含む）の算定方法

上 場 有 価 証 券.....主に、東京証券取引所の最終価格によっております。

店 頭 売 買 有 価 証 券.....日本証券業協会が公表する売買価格等によっております。

2. 開示対象から除いた主な有価証券の連結貸借対照表計上額

固定資産に属するもの	非上場株式	当連結会計年度
	(店頭売買株式を除く)	350 百万円

(2) デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

当連結会計年度（自 平成 11 年 4 月 1 日 至 平成 12 年 3 月 31 日）

該当事項はありません。

16. 関連当事者との取引

当連結会計年度（自 平成 11 年 4 月 1 日 至 平成 12 年 3 月 31 日）

該当事項はありません。